

決算説明会等での主な質疑応答内容

2021年3月期決算説明会後がありました（2021年5月25日～26日）主要な質疑応答を記載しています。

【質問】 収益認識基準の変更に対する影響はあるか。

【回答】 影響は軽微である。

【質問】 5Gはエレクトロニクス事業にとって今期または来期に向けてプラス要因になるか。

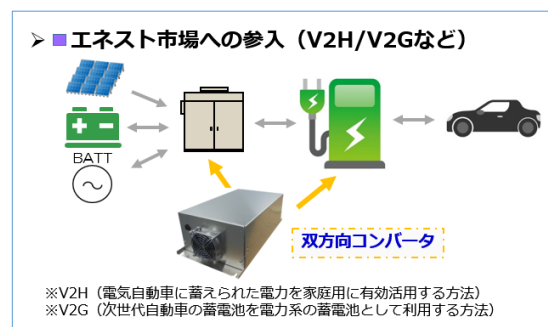
【回答】 5Gに限らず、社会的インフラに重要な電源のリニューアル等もプラス要因としていきたい。

【質問】 エネスト市場への参入という話があったが、脱炭素社会づくりに貢献していくことになり、今後市場が拡大すると思われるのか。

【回答】 エネスト市場は今後需要増が見込まれるため、当社もカーボンニュートラルに向けた取り組みを検討していく。

【質問】 エネスト関連市場への具体的な参入時期はいつか。

【回答】 前期までは、エレクトロニクス事業で長年培ってきた直流技術を生かしたEV関連などで、サンプル機供給などマーケティング活動を行っていた。今期から、その製品版の市場投入を開始する。



【質問】 医療用診断市場向け電源の新製品開発について、現在は開発中なのか。

【回答】 順次販売をスタートさせている。継続販売に加えてさらなるラインナップの充実に向けて開発・製品化を行っている。2021年3月期では、新型コロナウイルス感染症により需要が高まった医療市場（医療診断用X線電源）において、一般撮影X線装置用に加え外科用、回診車用などの電源のラインナップ充実による売上増があった。



【質問】 中国関連市場は上向くのか。中国で生産している[光半導体用溶接機\(CSW\)](#)は、影響は低かったのではないかと。

【回答】 CSWについては据付・検収等100%現地で出来ないこともあり、今後、新型コロナウイルス感染症の影響による人・モノの移動制限などが解消されれば上向く可能性もある。

【質問】 光学レンズ貼合せ装置(OLB)について「メカトロニクス事業部の基幹事業のひとつとして捉え、製品化を進め、本市場での深耕を図り、拡販」とのことだが、現在こういった製品の開発を進めているのか。

【回答】 スマホ用ディスプレイ貼合装置(MDB)で培った樹脂貼合技術を、車載・産業用ディスプレイ貼合装置(DB)に展開し、2020年、OLBの開発・製品化にめどがついた。今後ウェアラブル製品に使われる予定。

【拡販強化】

➤ ■OLB

MDB/DBで培った貼合技術をレンズ貼合に展開、120期よりウェアラブル市場において売上に寄与



【質問】 CSW について「中国向けは光通信用途以外にも期待」とのことだが、具体的にどのような分野で使われると期待しているのか。実績はあるのか。

【回答】 赤外線センサで実績があり、車載センサ等への展開も期待できる。

【質問】 前期上期は自動車生産の低迷で苦戦したと思うが、今期の全体の流れも回復してくるので、ケミトロニクス事業関連も含め上向いていくと考えられるが、どうか。

【回答】 基幹部品メーカーなどで生産を抑えていることもあるので、慎重にみていきたい。

【質問】 間々田工場のウェハがあったラインはどう使うのか。

【回答】 コンポーネント事業における新市場向け製品等の生産ラインとして活用を計画している。

【質問】 半導体デバイス部の高圧ダイオード MD15EP06 は、これから発売する予定の商品なのか。開発に至った経緯と背景、また従来品との機能面での違いはなにか。

【回答】 121期下期にリリース予定。現在は特定のお客様に評価用サンプルを提供している状況。国内唯一の高圧ダイオードメーカーとして半導体製造60年以上の実績と蓄積してきた技術を活かし、既存の大電流を中心とした高圧製品ラインナップに加えて、小電流についても拡充を図る。今回の開発により、小電流を必要とするデンタルX線装置や工業用X線装置、その他高圧電源の高圧整流用として市場を広げることを期待。海外製に比べ逆回復時間が約3割早くなるため、高周波電源に適応、小型でありながら放熱性に優れる。



以上